

# 麦克风阵列解决方案及设 计需求

版本: V0.3

2022-01-09





深圳市南山区粤海街道科技南十二路 18 号长虹科技大厦 0755 - 86662489

WWW. SOUNDEC. COM

## 修订历史

修订版本	修改日期	内容概要
VO. 1	2021-12-30	首版产品需求整理
V0. 2	2022-01-05	增加数据流程图
VO. 3	2022-01-09	修正麦克风阵列麦克风类型选择及算法处理
		时间要求



#### 目录

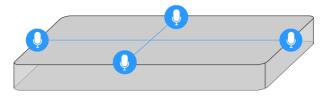
1.麦克风阵列类型	4
2.麦克风选型要求	5
3.喇叭选型及设计要求	6
3.1 喇叭选型	6
3.2 喇叭声学设计要求	6
4.结构设计要求	7
4.1 麦克风腔体设计原则	7
4.2 麦克风安装结构设计建议	7
4.3 其他结构设计建议	8
5.软件功能要求	8
5.1 麦克风阵列算法功能需求	8
5.2 按键功能需求:	9
5.3 LED 灯功能需求:	9
5.4 与主控设备连接功能需求	10
5.5 系统功能需求	10
6.数据流程图	11
6.1 会议音箱类数据流	11
6.2 前端抡旁横块粉据流	12



# 1.麦克风阵列类型

#### 1) 四麦克风立体阵列

四麦克风立体阵列总体呈正方形,各个麦克风在立体空间等距摆放,偏差小于 0.5mm。 产品形状是长方形或正方形或圆形,麦克风按着等距摆放,组好的麦克风和 SPK 形成以 SPK 是圆心的摆放。



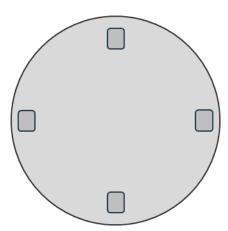
#### 2) 四麦克风线型阵列

四麦克风线型阵列总体呈直线,总长度在 120mm,建议各个麦克风在直线上等距摆放,偏差小于 0.5mm;各个麦克风朝向相同,两个麦克风间距 35mm 或者 40mm;



#### 3) 四麦克风环型阵列

四麦克风环型阵列总体呈圆形,各麦克风在圆周上等距摆放,圆周直径推荐70mm到90mm。



#### 4) 两麦克风线型阵列

两麦克风线型阵列总体呈直线,建议各个麦克风在直线上等距摆放,偏差小于 0.5mm;各个麦克风朝向相同,连哥哥麦克风间距在60mm。

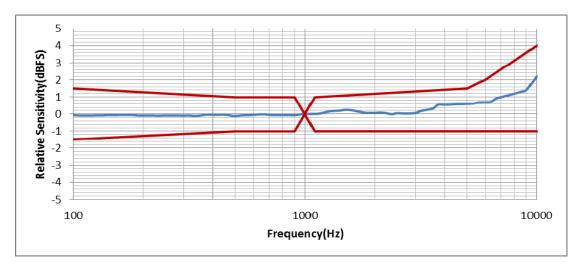




# 2.麦克风选型要求

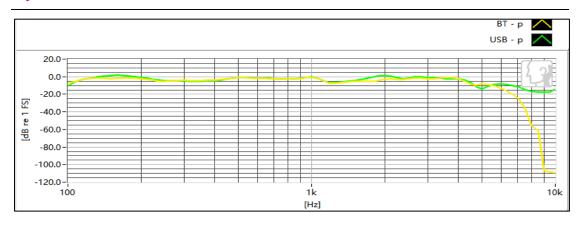
麦克风阵列方案:采用数字麦克风设计;数字麦克风参数指标要求如下:

- 灵敏度 (Sensitivity): >-26dB@94dB 1KHz
- 信噪比 (SNR): > 64dB,最佳大于 67dB
- 声学过载点 (AOP): >=120dB SPL
- 麦克风单体谐波失真(THD): <= 1%(1KHz)
- 麦克风相位一致性要求: <3°



■ 整机麦克风频响曲线最好 7KHz 以后开始缓慢衰减,如下图:

## SOUNDEC



# 3.喇叭选型及设计要求

#### 3.1 喇叭选型

- (1)单体扬声器在 150Hz-7KHz 总谐波失真<1%。若低频部分失真较高,建议对低频进行均衡或滤除。
- (2) 音质要求较高的产品,额定功率下的 THD+N 全频段(20Hz-20KHz) 尽量<0.5%。

#### 3.2 喇叭声学设计要求

- (1) 在结构设计时,包装喇叭和麦克风距离尽量远;扬声器到麦克风的声压最好不要超过90dB(在麦克风处测得)。
  - (2) 喇叭和麦克风的密封隔离度至少大于 15dB, 最好 20dB 以上。
  - (3) 保证扬声器与麦克风在不同腔体内,做好密封,防止内部串音。
- (4)结构设计时,应保证扬声器发声方向和麦克风拾音方向不在同一方向,并且尽量保证最大距离。
  - (5) 扬声器设计时要进行减震处理,避免由结构振动导致内部声音



传播,并与其它构件保持一定间距,防止碰撞发声异常声音信号。

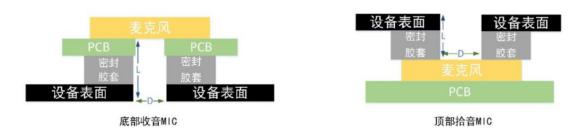
(6) 喇叭在最大音量下,保证麦克风录音不发生截幅。

# 4.结构设计要求

## 4.1 麦克风腔体设计原则

- (1) 保证人声可以直达每个拾音孔,各麦克风之间不要有障碍物。
- (2) 麦克风安装位置应尽量远离振动和干扰源(如:电机、触控板、按键板)。
- (3)为保证密封性,面板与 PCB 板之间以及麦克风本身都要选用硅胶保护套、密封圈或泡棉密封,推荐 Poron 材料。

## 4.2 麦克风安装结构设计建议



- (1)上图左边是麦克风拾音孔在底部,右边是麦克风拾音孔在顶部, 其中 L 表示深度, D 表示开孔直径。
- (2) 结构设计时,需要保证开孔尽量大(D >2mm),孔深尽量小(L<2mm)。

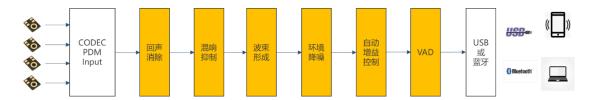


### 4.3 其他结构设计建议

- (1)为避免麦克风直接硬性触控面板产生震动,采用的硅胶保护套 尽量选择软、稳。推荐 Poron 材料。
  - (2) 扬声器发音方向和麦克风拾音方向呈 90°或 180°
  - (3) 防止麦克风拾音孔被堵,需要安装防尘网。

# 5.软件功能要求

## 5.1 麦克风阵列算法功能需求



- (1)回声消除(AEC):在系统最大音量(85dB)情况下,远端讲话无回声,回声消除深度在>50dB;
- (2) 混响抑制 (De-reverb): TR60 的混响时间在 0.5s-0.8s:
- (3) 波束形成 (BF):
  - A. 语音增强:增强讲话人方向的声音
  - B. 声源定位:精度±15°
- (4) 环境降噪 (ENC):
  - A. 稳态的白噪音完全消除;
  - B. 环境噪音降噪深度: >12dB, 降噪深度可调节;
- (5) 自动增益控制 (AGC):



- A. AGC 参数可配置, 匹配不同声学设计;
- B.1米到3米距离,远端听到的声音振幅是一致的。
- (6) 语音活动检测(VAD);
- (7) 支持双讲:远端和近端同时讲话,远端听到近端声音,音量抑制不超过 50%:
- (8) 支持麦克风 EQ 调节,至少 4 段;
- (9) 支持扬声器输出 EQ 调节,至少 4 段。

## 5.2 按键功能需求:

- (1) 电源键:开机和关机设备;
- (2) 音量+键:设备音量增加; ●
- (3) 音量-键:设备音量减小: ■
- (4) 静音键:打开和关闭麦克风;
- (5)接听/挂断键(复用):来电是接听,通话中是挂断;
- (6) 切换键:传输模式切换: USB 模式/蓝牙模式;
- (7) 功能键:一键启动 Teams 或飞书或腾讯会议应用; 🕶

说明:有一些麦克风阵列应用不需要这么多按键,如:仅有拾音功能,应用在机器人产品。

## 5.3 LED 灯功能需求:

(1) 电源指示灯:



- A. 开机状态灯: 橙色:
- B. 充电状态灯: 充电过程中: 红灯; 充满: 绿灯;
- (2) 音量+指示灯: 默认灯不亮, 工作: 白灯:
- (3) 音量-指示灯: 默认灯不亮, 工作: 白灯:
- (4) 静音指示灯:
  - A. 麦克风工作:绿灯;
  - B. 麦克风关闭: 红灯;
- (5) 接听/挂断指示灯: 默认灯不亮, 工作: 白灯;
- (6) 蓝牙功能指示灯: 蓝灯;
- (7) 功能键指示灯: 默认灯不亮, 工作: 白灯:

#### 5.4 与主控设备连接功能需求

- (1) USB 连接方式:
- (2) 蓝牙连接方式;



#### 5.5 系统功能需求

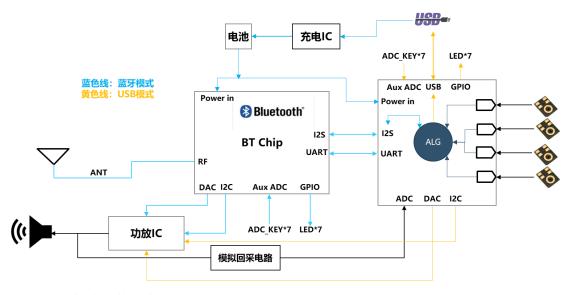
- (1) 麦克风增益大小可进行配置;
- (2) 四麦克风阵列, 采样率支持 16KHz/24bits;
- (3) 两麦克风阵列, 采样率支持 48KHz/24bits;
- (4) DAC 输出, 采样率支持 48KHz/24bits, 并兼容 44.1KHz/24bits;
- (4) 支持 UAC1.0 版本协议, 兼容 Windows7、Windows10、 Android 系统、MACOS:



- (5) 支持 HID 通讯并可以进行二次适配和开发;
- (6)会议音箱扬声器最大音量(正对出音方向,测试距离 0.5 米),播放音乐模式和通话模式要到 85dB;
  - (7) 至少保证 2组 I2S 通路并发正常工作;
  - (8) I2C 通讯正常并稳定通信:
  - (9) UART 在 115200 速率下稳定通信,不丢数据;
- (10) Flash 中要有保持算法数据的区域(这个区域是可以灵活配置的,不固定数据区域大小),开关机数据不丢失;
  - (11) USB <--> CODEC <--> I2S 之间的数据要保持同步。

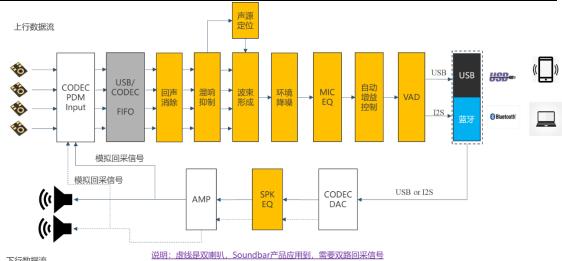
# 6.数据流程图

#### 6.1 会议音箱类数据流



ALG 部分(算法)数据流

#### SOUNDEC

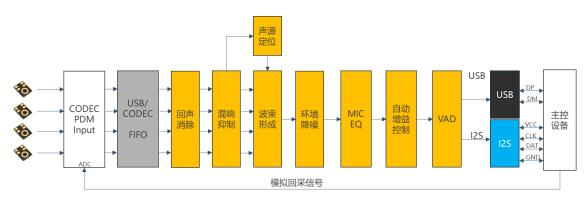


下行数据流

#### 说明:

- 从回声消除到环境降噪算法处理时间小于 15ms,最好在 10ms 以内处理完成; **(1)**
- (2) 麦克风的增益控制可以调节;
- (3) 麦克风采样率支持多采样率选择并可以配置。

#### 6.2 前端拾音模块数据流



#### 说明:

- **(1)** 从回声消除到环境降噪算法处理时间小于 15ms;
- 麦克风增益可以调节; (2)
- 算法处理后的音频信号信噪比 > 32dB。 (3)